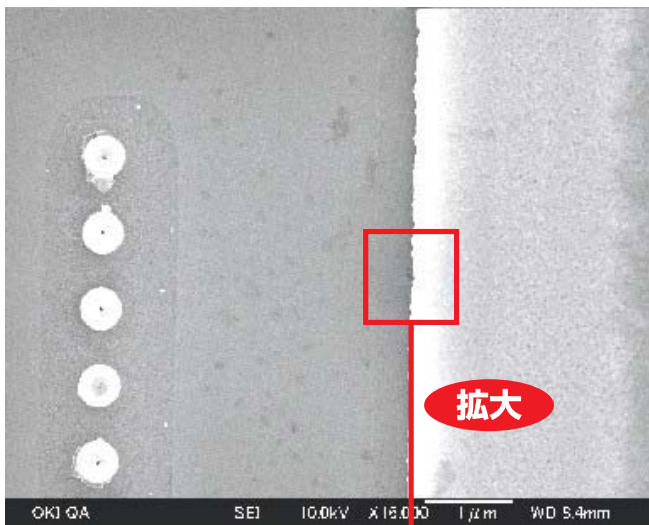


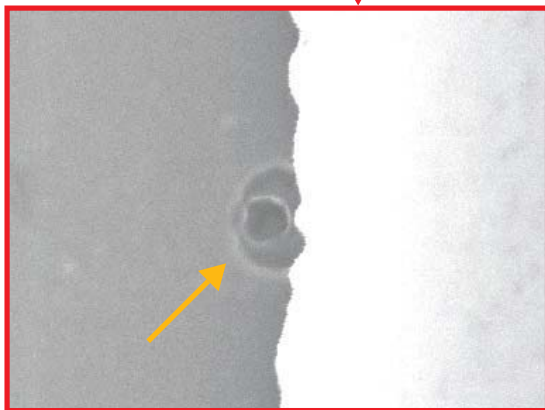
# 組立工程の半導体静電気障害対策

電子機器組立工程における半導体部品の静電気障害対策を支援します。

1. 電子機器組立工程における半導体部品静電気破壊の各種再現実験
2. 半導体部品の静電気破壊メカニズム構築
3. 電子機器組立工程の静電気帯電、静電気放電の調査にて、静電気障害防止の工程対策、半導体部品の静電気保護設計対策のご提案



拡大



MOSTランジスタのゲート酸化膜破壊の例

- ・ 静電気測定ノウハウを保有し帯電～放電のメカニズムを特定
- ・ 保護回路設計ノウハウ、保護回路の長所短所をふまえ適確な対策を提案
- ・ 電子部品組立における公的規格 (IEC61340-5-1/5-2)等に準拠した、静電気管理、静電気対策実現を支援、静電気対策部材、備品などの性能評価などもサポート

## 故障解析特定

- ・ 界層解析
- ・ 発熱解析
- ・ 発光解析

再現

## 故障現象再現

- ・ HBM ・ MM ・ CDM
- ・ TLP ・ その他試験

究明

## サージ種類の特定

- ・ ESD熱破壊
- ・ ESD電界破壊
- ・ EOS破壊

## 工程静電気調査

- ・ 帯電調査
- ・ 放電現場特定

## 対策のご提案